



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



水溶添加劑

StayClean-F

Water-soluble Additive

切割加工中防止接線頭腐蝕



防止接線頭腐蝕

大口徑，小晶粒晶粒在加工時，由於工作物與切削水之間長時間接觸，接線頭有時會被腐蝕。在切削水中添加StayClean-F，能夠在工作物的表面形成極薄的保護層，有效地防止接線頭腐蝕。

防止污染

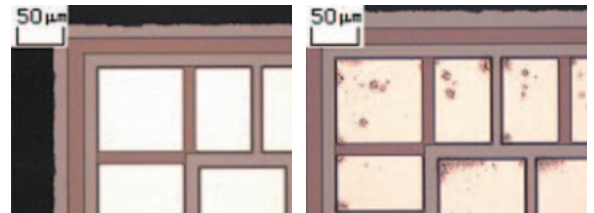
現有離心清洗無法完全除淨的微粒，也可通過在切削水中添加StayClean-F，促使其脫離工作物表面，防止微粒污染。

無環境污染·低運行成本

StayClean-F不含有任何RoHS物質及PFOS等限制類化學物質，可在正常切割條件*下使用。同時，即使稀釋到數千分之一，甚至為防止腐蝕而稀釋到數萬分之一，仍然可以有效地發揮防污效果，實現低成本運行。

*需循環使用時，請向迪斯科銷售部分諮詢。

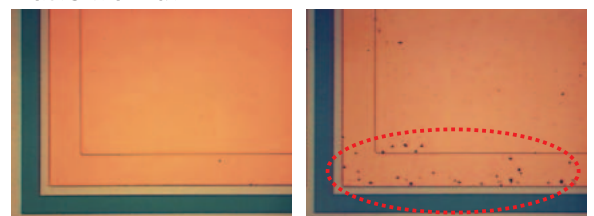
■ 防接線頭腐蝕效果比較



使用StayClean-F時

只使用純水

■ 防污效果比較



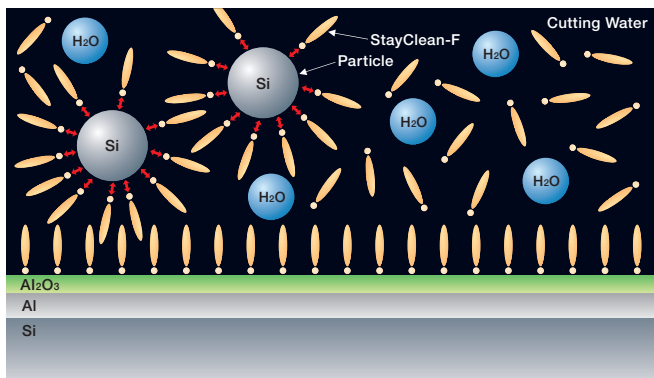
使用StayClean-F時

只使用純水

水溶添加劑

StayClean-F

Water-soluble Additive

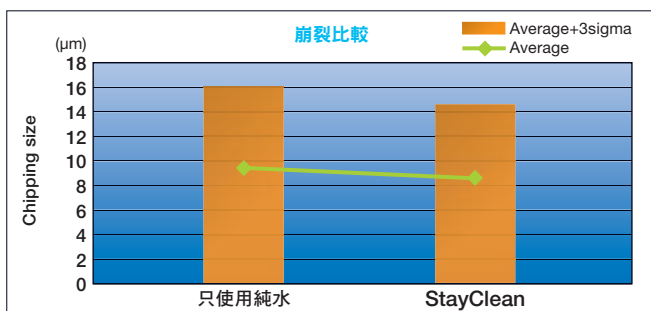
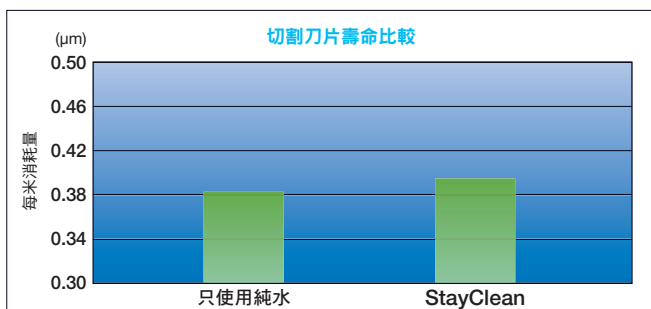


■原理

- StayClean-F中的成分在工作物表面形成保護層，有效地防止接線頭腐蝕及微粒污染。
- 在離心清洗時，同時清除StayClean-F成分。

保持同樣的加工結果

即使添加StayClean-F、也能夠保持通常使用純水時的加工結果。



Workpiece : Si wafer Spindle rpm : 40,000 (min⁻¹)
Blade : NBC-ZH Feed speed : 60 mm/s

StayClean-F 技術規格

StayClean-F	
原液外觀	無色透明液体
主成分	水溶性高聚合物
pH(原液)	4.7
密度 (15 °C)	1.03 g/cm ³
分解性 (0.1 %時)	mg/L COD 32 (JIS K1002-17) mg/L BOD 2.5 (JIS K0102-21)
稀釋比率	倍 1,000 ~ 10,000 (0.1 ~ 0.01 %)

StayClean注入器

電源、電壓	V	AC90 ~ 230	單相 50/60 Hz
入口水溫	Deg C	20 ~ 25	
入口水壓	MPa	0.2 ~ 0.5	
對應水流量	L/min	2 ~ 20	
原液 注入率	%	0.1 ~ 0.01 (1,000 ~ 100 ppm)	
裝置尺寸 (W x D x H)	mm	注入器 200 x 300 x 500 不包括突起部分 儲瓶器 357 x 392 x 440 不包括突起部分	
裝置重量	kg	注入器 約22 (無水時) 儲瓶器 約10 (無水時)	

■注意事項

使用前

- 產品安全技術說明書 (MSDS) 中詳細記載了相關注意事項，因此在使用StayClean-F之前，請務必仔細閱讀。
- 請不要用於其他用途。

使用時

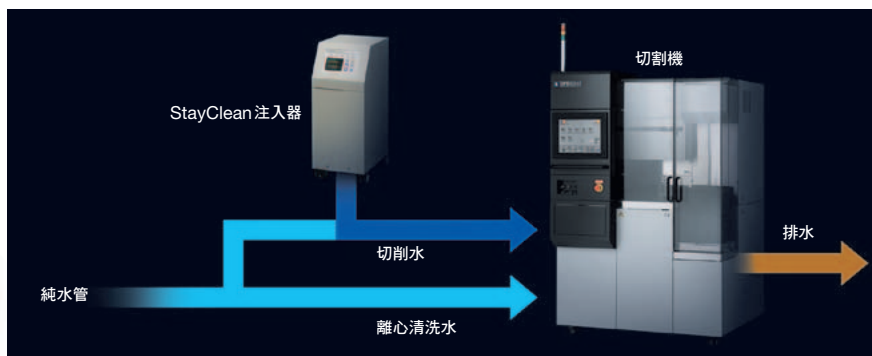
- 請使用合適的防護眼鏡、手套，避免藥液接觸眼睛、皮膚。
- 請勿與其他化學品 (特別是強酸、強鹼性的化學品) 同時使用。

保管時

- 請於冷暗場所保管，避免直射陽光，但不要放入冷凍庫。
- 請保持密封。
- 在密封狀態下，品質保證期間為，從生產日期起1年。

StayClean注入器

使用專門開發的StayClean注入器，可以保證低濃度切削水的安定供給。(符合CE標誌的要求)



DISCO CORPORATION

東京都大田區大森北2-13-11 〒143-8580

Phone: 03-4590-1100 Fax: 03-4590-1075 www.disco.co.jp